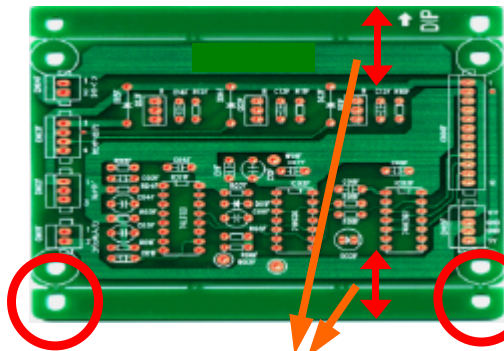


自動実装を意識した基板設計の必要な条件

1、プリント基板仕様



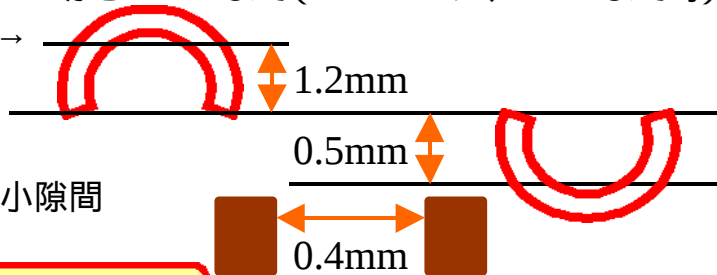
対応可能基板寸法 → min 50*50
Max 508*381
推奨基板寸法 → min 50*50
Max 330*250

基準穴の位置 → 5mm 左右要
基準穴径は4φ

基板端面から4mm以内の部品は実装不可

基板板厚は1.0mmから2.0mmまで(MPA-G1のみ4.0mmまで可)

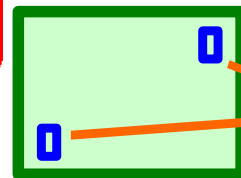
基板反り限度 →



部品間隣接最小隙間

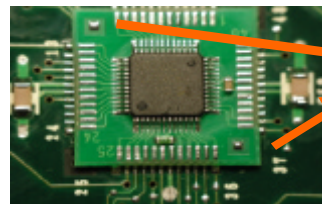
2、認識マークについて

基板認識マーク



基板対角線上に必要

部品認識マーク

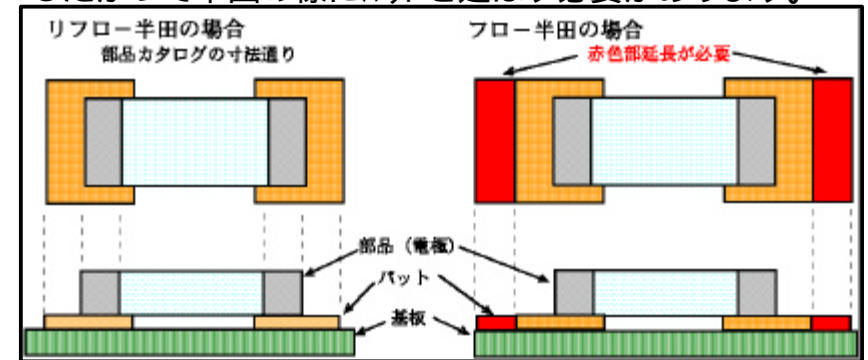


QFP、BGAについては
部品1点毎に部品対角線
上に必要

認識マークの種類は丸、三角、四角、菱形のどれでも可
ただしハンダメッキか銅箔か金メッキ処理の事

3、70-半田用の'パッド'形状について

- 部品カタログにはリフロー用の推奨サイズのみ記述されています。
- リフローでは部品と基板の間に印刷段階で半田が入りますが、70-では接着時に密着しますので半田はなじみません。
- したがって下図の様にパッドを延ばす必要があります。



4、アキシャル、ラジアル自動実装条件

基板の仕様については左図『1、プリント基板仕様』と同じです

